
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

我們估計，經扣除[編纂]、我們就[編纂]應付的費用及估計開支後，假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述的最高[編纂]），我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

根據我們的策略，我們擬將[編纂]淨額用於下列用途，惟須視乎我們不斷演變的業務需求及不斷變化的市況而變動：

- (a) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於擴大及升級我們高附加值產品的生產能力，以滿足AI驅動的需求，並提升我們的生產能力。特別是：
 - (i) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於大幅增加金灣生產基地（廣東省珠海市）的HLC PCB及高階HDI PCB的生產能力，主要用於採購新一代高精度自動化設備，包括激光鑽孔機、PLB水平電鍍線、CT滲透測試儀及CCD背鑽機；及
 - (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於升級龍川生產基地（廣東省河源市）的AI端側及智能終端應用的多層FPC產能，主要採購高精度設備，用於服務於AI智能手機、高端可穿戴設備、智能家居設備及顯示屏所採用的輕量化、高度集成化多層FPC，包括卷對卷高速曝光機、二氧化碳激光鑽孔機、紫外激光鑽孔機以及皮秒激光切割機。
- (b) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於提升我們在新一代電子信息技術領域的研發及技術儲備。特別是：
 - (i) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）預計將分配用於在AI算力基礎設施及下一代高速互連解決方案方面尋求突破，包括HLC PCB

未來計劃及[編纂]用途

及高階HDI PCB、AI加速卡、Z向互聯背板及超高速交換機PCB（包括224G/448G、CPO/CPC）的研發，以及下一代超低損耗材料的應用及大規模量產工藝；及

- (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）預計將用於推進我們在智能網聯汽車高端汽車電子PCB技術方面的前瞻性佈局，重點面向毫米波雷達及域控的車規級PCB。

- (c) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於償還我們部分現有的計息銀行借款。擬償還的銀行貸款到期日介乎2027年至2034年，年利率介乎2.4%至4.5%。預計此舉將優化我們的資本結構，降低資產負債比率，減少利息支出及釋放現金流用於核心業務發展，從而提升我們在應對宏觀經濟波動時的應變能力。

- (d) [編纂]淨額的約[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於營運資金及其他一般企業用途，包括採購原材料、員工薪酬、物流及其他日常營運需求，以支持我們業務規模的持續擴大及全球化。

倘我們的[編纂]淨額不足以為上述目的提供資金，我們擬透過多種方式（包括手頭現金、銀行貸款及其他借款）撥付餘額。

任何因行使[編纂]而收取的額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂]淨額[編纂]港元（經扣除估計[編纂]以及我們就[編纂]應付的其他費用及開支，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述的最高[編纂]））。

倘[編纂][編纂]淨額毋須即時作上述用途，或倘我們無法按計劃將任何部分發展計劃付諸實行，我們或會將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構的短期計息賬戶（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）。於此情況下，我們將遵守上市規則所規定的所有適用披露規定。